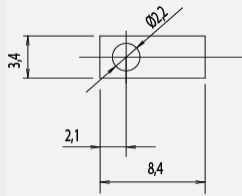
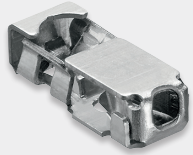
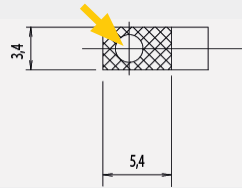
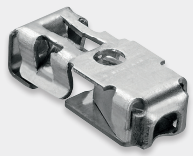


1. Produkt und Leiterplatten Lötbild | Product and PCB layout

Empfohlener Lötpastenauftrag (Schablonenstärke):
< 0,12 mm
Recommended soldering paste (stencil thickness):
< 0.12 mm



Fläche für Lötpastenauftrag
Area for solder paste application



MICROCON SMD PURE

Angaben für den Reflow Lötprozess:

Lötprofil in Anlehnung an JEDEC J-STD-020/E Bild 5-1 für bleifreie Baugruppen bis zu einer Maximaltemperatur von 260°C.

Da der Lötprozess weiteren Einflussfaktoren wie z.B. Lötpaste, Fertigungsanlage, Leiterplattenparameter unterliegt, empfehlen wir die Durchführung von Verarbeitungstests und die Erstellung eines optimalen Lötprofils unter realen Fertigungsbedingungen im Zuge des Design-in Prozesses.

Specifications for the reflow soldering process:

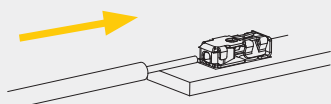
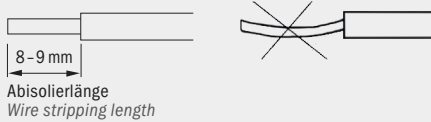
Soldering profile based on JEDEC J-STD-020/E Fig. 5-1 for lead-free assemblies up to a maximum temperature of 260°C.

As the soldering process is subject to other influencing factors such as solder paste, production equipment, PCB parameters, we recommend carrying out processing tests and creating an optimum soldering profile under real production conditions in the course of the design-in process.

2. Leiter einführen & lösen (horizontal) | Wire insertion & release (horizontal)

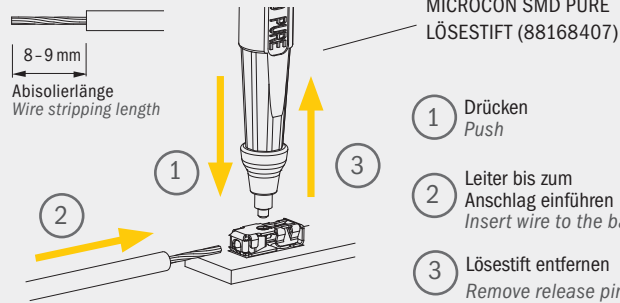
Leiter einführen | Wire insertion

Starre Leiter 0,2 - 0,5 mm²
Solid wires 0.2 - 0.5 mm²



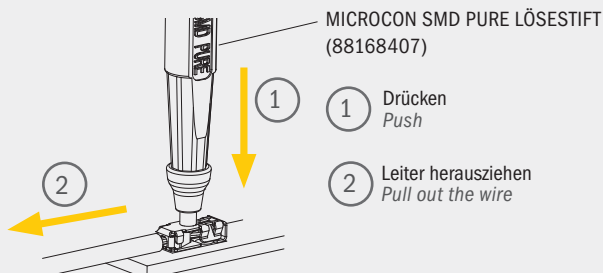
Leiter bis zum Anschlag einführen
Insert wire to the back end

Flexible Leiter 0,5 mm²
Flexible wires 0.5 mm²



- 1 Drücken
Push
- 2 Leiter bis zum Anschlag einführen
Insert wire to the back end
- 3 Lösestift entfernen
Remove release pin

Leiter lösen | Wire release

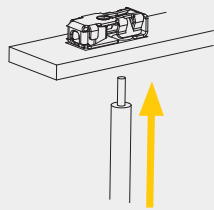
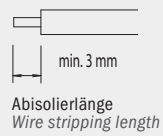


Alternative für eindrähtige Leiter: Drehen und Ziehen
Alternative for solid wires: Twist & pull

3. Leiter einführen & lösen (vertikal) | Wire insertion & release (vertical)

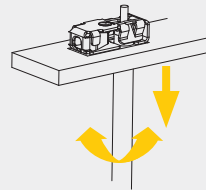
Leiter einführen | Wire insertion

Starre Leiter 0,5 mm² | Solid wires 0.5 mm²



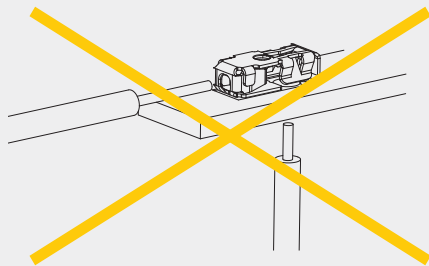
Leiter bis zum Anschlag einführen
Insert wire to the back end

Leiter lösen | Wire release



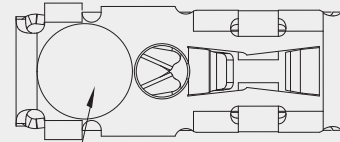
Leiter drehen und Ziehen
Twist & pull

4. Bitte beachten | Please note



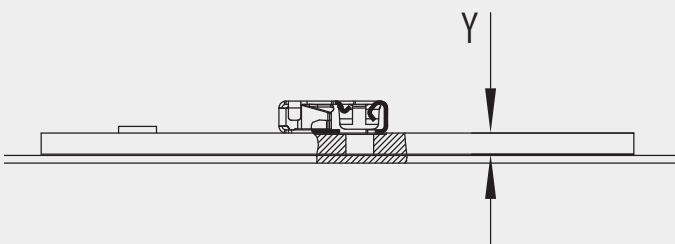
Entweder horizontalen **ODER** vertikalen Anschluss verwenden.
Use either horizontal **OR** vertical terminal.

5. Bestückungsinformation | Pick & place information



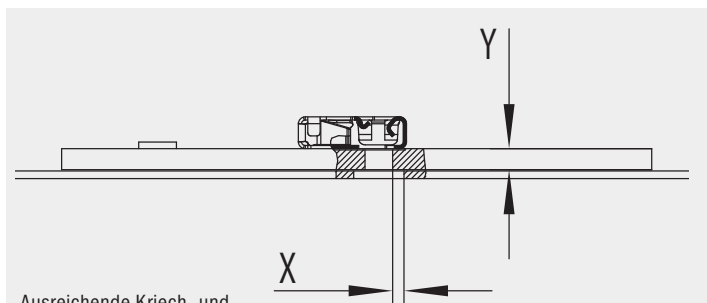
Ansaugfläche Ø 2,5 mm
Nozzle area Ø 2.5 mm

6. Kriech- und Luftstrecken beim Verbau von Leiterplatten mit Loch für das vertikale Stecken beachten Mind creepage and clearance distances for the mounting of PCBs with hole for vertical connection



Ausreichende Kriech- und Luftstrecke Y zur Leiterplattenbefestigungsfläche beachten.
Kriech- und Luftstrecken sind durch den Einbau sicher zu stellen.

Please consider sufficient creepage and clearance distance Y between life part and mounting surface..
Creepage distances and clearances must be ensured by the installation.



Ausreichende Kriech- und Luftstrecke X + Y zur Leiterplattenbefestigungsfläche beachten.
Kriech- und Luftstrecken sind durch den Einbau sicher zu stellen.

Please consider sufficient creepage and clearance distance X + Y between life part and mounting surface..
Creepage distances and clearances must be ensured by the installation.



MICROCON SMD PURE
Video auf Youtube
Video on Youtube